

W2W 晶圓對準接合機

一、系統簡介:

1. 設備名稱: W2W 晶圓對準接合機
2. 廠牌: EVG
3. 儀器型號: EVG 501&610
4. 設備功能: Wafer to Wafer 晶圓對準接合製程
5. Wafer Size: 6 吋



二、規格:

1. 乾式機械幫浦一式可達真空值約 $5E-2$ torr。
2. 背面對準物鏡+正面 IR 光源+手動對準模式。
3. Bonding force max 20 kN。
4. Max 溫度可達 450°C with a heat up ramp of $30^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 。



三、特殊注意事項:

1. 特殊製程須經儀器負責人同意，方可使用。
2. 實際開放使用情形以 TSRI 網頁為準。
3. 易造成 chamber 污染之材料嚴禁放入 chamber，違者取消磁卡資格。